

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220629

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称 及人员姓名	泰康资产：王铎霖
时间	2022年6月28日上午09:30-11:30
地点	公司511会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书杨平彩女士。
投资者 关系活动 主要内容 介绍	<p>管理层介绍公司基本情况，并与投资者就半导体工艺材料、半导体显示材料、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p>问 1：请简要介绍公司的定位及产业布局。</p> <p>答：公司是国际国内领先的关键大赛道领域中相关核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，现已在半导体制程工艺材料领域、半导体显示材料领域、半导体先进封装材料领域三个细分赛道中，布局了多款进口替代类“卡脖子”材料及其上游部分核心原材料。</p> <p>具体来看：1、在半导体制程工艺材料领域，公司围绕集成电路前段制造的CMP抛光环节布局了CMP抛光垫、抛光液、清洗液等核心耗材，其中CMP抛光垫产品深度渗透国内主流晶圆厂客户供应链，CMP抛光液、清洗液产品加速开拓市场，CMP制程工艺材料系统化解方案初现成效；2、在半导体显示材料领域，公司围绕新型OLED显示中的多款核心“卡脖子”材料进行布局，其中黄色聚酰亚胺YPI产品已在国内主流面板厂持续放量，光敏聚酰亚胺产品PSPI已实现小批量供货，面板封装材料Ink的客户端验证情况良好；3、在半导体先进封装材料领域，公司前瞻性布局底部填充胶（Underfill项目）、临时键合胶（TBA项目）、半导体封装用光敏聚酰亚胺（PSPI项目），相关新材料及其上游核心原材料的开发按期推进。此外，在公司传统业务—打印复印通用耗材业务领域，鼎龙保持全产业链布局竞争优势地位，持续提高效率，实现稳健经营。</p>

问 2：公司二十多年在材料领域持续研发、创新，积累了哪些经验？

答：1、在研发技术方面：公司是一家重视技术整合和技术平台的公司，在材料领域利用自己的人才团队的稳定，技术的积累和行业的经验打造了七大技术平台，将公司成功研发高端材料的技术经验运用到新项目中，有效加速了新材料产品的开发和产业化进度。2、在材料开发理念方面：公司积累二十一年来材料研发的经验，总结出四个坚持：一是坚持材料技术创新与人才团队培养同步；二是坚持材料技术的进步与知识产权建设同步；三是坚持材料技术创新与上游原材料的国产化培养同步；四是坚持材料技术创新与用户验证工艺发展同步。这四个坚持帮助公司建立了验证评价能力、供应链管理、知识产权布局等方面的优势，为公司未来发展奠定了坚实的理念基础。

问 3：请简要介绍公司 CMP 抛光垫业务情况？

答：公司 CMP 抛光垫产品已成功打破垄断，成为国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的 CMP 抛光垫供应商，深度渗透国内主流晶圆厂客户供应链，领先优势明显。近几年 CMP 抛光垫业务的收入、利润高速增长，现已实现规模盈利，成为公司新的盈利增长极。

问 4：公司对 CMP 抛光垫的市场空间有怎样的预期？

答：在国内市场方面，公司 CMP 抛光垫产品已在国内各主流晶圆厂客户放量，并成为部分客户的第一供应商。考虑到下游在 5G、新能源汽车、电子级消费等领域的应用，半导体的产能规模将持续显著增长，且国内市场的增速高于全球半导体的产能增速；同时晶圆制造技术升级进步将带来 CMP 工艺步骤大幅增长，CMP 抛光材料在晶圆制造过程中的消耗量增加。同时在先进制程领域，抛光垫的用量会更多，因此国内 CMP 抛光垫市场空间拥有持续扩容的潜力。在海外市场方面，CMP 抛光垫的市场比国内更大，公司也计划开始拓展海外市场。

问 5：公司 CMP 抛光液业务的情况是怎样的？

答：公司 CMP 抛光液产品的研发工作已全面展开，Oxide, SiN, Poly, Cu, Al 等 CMP 制程抛光液产品多线布局，目前在客户端的验证反馈情况良好，部分产品已通过各项技术指标测试，其中：Oxide 制程某抛光液产品已取得小量订单，Al 制程某抛光液产品在 28nm 技术节点 HKMG 工艺中通过客户验证，进入吨级采购阶段。另外，公司已实现抛光液上游核心原材料研磨粒子的自主制备，打破国外企业对研磨粒子的垄断，保障了公司抛光液产品供应链的安全、稳定，提升了公司抛光液产品的盈利能力，增强了公司抛光液产品的核心竞争力。

问 6：公司半导体制程工艺材料的几款产品，核心竞争力有哪些？

答：1、相比于海外友商，公司具有本土的服务优势和国产化替代优势。2、公司重视供应链管理，相关产品的核心原材料采用了自主研发生产或者与国内上游供应商合作的方式，保障了原材料供应的安全、稳定，对公司持续改良产品性能提供了帮助，同时在成本端也能带来毛利优势。3、公司布局了集成电路前段制程 CMP 环节的多款核心耗材，可以提供 CMP 制程工艺材料系统化的解决方案，有助于提高下游晶圆厂客户 CMP 环节工艺的稳

	<p>定性。</p> <p>问 7：在半导体显示材料领域，公司 YPI 产品市场推广的进度如何？</p> <p>答：今年公司柔性面板基材 YPI 产品处于快速放量阶段，一方面会全面进入国内四家主流面板厂客户的供应链，另一方面在各家客户的订单情况也在持续提升。虽然下游 AMOLED 工厂受终端智能手机订单和 IC 缺货的影响，下游需求暂时未能完全释放，但智能手机面板柔性化、曲面化趋势明显，公司 YPI 产品全面导入、放量对其销售快速增长提供了坚实的基础。</p> <p>问 8：公司其他面板显示新材料产品的推进进度是怎样的？</p> <p>答：公司光敏聚酰亚胺 PSPI 产品已经拿到订单，实现了小批量供货，武汉本部 PSPI 一期 150 吨年产能已经建成，二期产线将在仙桃开工建设；面板封装材料 Ink 产品在客户端的验证情况良好。</p> <p>问 9：请您介绍下公司在半导体先进封装材料领域的布局？</p> <p>答：公司在先进封装材料领域的布局从 2021 年开始，这是公司新近布局的一个材料领域。封装环节是集成电路制造中的重要环节，先进封装对进一步提升集成电路性能也非常重要，但其中用到的先进封装材料大部分是进口的，难度大，价值高，未来的成长空间也较高。公司已经全面启动了先进封装材料项目，相关新产品及其上游核心原材料按计划开发，产业化建设也同步进行。</p> <p>问 10：公司打印复印通用耗材业务板块的情况是怎样的？</p> <p>答：公司在打印复印通用耗材板块拥有全产业链优势，耗材业务上游的核心盈利点—彩粉、耗材芯片业务经营情况良好。近几年硒鼓行业竞争压力大，市场集中度提升，硒鼓业务的经营业绩在前几年承受一定压力。但随着公司持续对硒鼓端进行降本增效、优化管理、严格管控风险等系列举措，公司硒鼓产品的盈利能力得到改善，硒鼓业务目前已扭亏为盈。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 6 月 28 日